

TOSHIBA ANNUNCIA NUOVI CHIP PER COLLEGARE FOTOCAMERE E DISPLAY NEI TERMINALI MOBILI

I nuovi chip con funzionalità di bridge raggiungono velocità di trasferimento dei dati fino a 800 Mbps per collegare fotocamere e display ad alta risoluzione

Mobile World Congress, 17 febbraio 2010 – [Toshiba Electronics Europe](#) ha annunciato oggi la disponibilità di nuovi chip con funzionalità “bridge” utilizzabili nella realizzazione di telefonini e terminali mobili. Si tratta del circuito integrato TC358740XBG che collega il bus seriale per fotocamere CSI (Camera Serial Interface) MIPI® (Mobile Industry Processor Interface) al bus per display MDDI® (Mobile Display Digital Interface), e dei modelli TC358760XBG e TC358761XBG che collegano il bus seriale per display DSI (Display Serial Interface) al bus MDDI-MIPI. Questi nuovi prodotti fanno da ponte tra le interfacce seriali ad alta velocità che collegano i processori applicativi e in banda base con le fotocamere e i display ad alta risoluzione che vengono utilizzati nei telefonini intelligenti, nei terminali mobili per l'accesso a internet, nei netbook e in tutti gli altri dispositivi portatili ad alte prestazioni. I nuovi chip rappresentano l'aggiunta più recente al vasto catalogo di soluzioni SoC (System on Chip) dedicate alle periferiche integrate per applicazioni mobili di Toshiba.

I telefoni intelligenti, o smartphone, e tutti gli altri dispositivi mobili sono sempre più ricchi di funzionalità, come la riproduzione di video ad alta definizione, grafica tridimensionale, cattura di segnali video e persino videoconferenza. Supportando le interfacce MIPI e MDDI ad alta velocità, i nuovi circuiti integrati bridge di Toshiba permetteranno ai clienti di progettare terminali mobili che possano far comunicare a banda larga il display, la fotocamera e il processore applicativo e in banda base integrati nel telefono, offrendo ai consumatori finali una qualità delle immagini video senza compromessi.

Il chip bridge per fotocamera TC358740XBG collega le fotocamere con interfaccia MIPI ai processori applicativi o in banda base tramite l'interfaccia. Il chip bridge supporta l'interfaccia MDDI 1.2 Type 2 sul lato host e fino a due fotocamere, quella primaria mediante un collegamento MIPI e quella secondaria mediante un collegamento MIPI o una porta parallela. Il bridge consente di collegare le interfacce seriali ad alta velocità sul lato host via MDDI e sul lato fotocamera via MIPI CSI-2 supportando una fotocamera primaria fino a 12 megapixel e una fotocamera secondaria fino a 2 megapixel in uno stesso terminale. E' compatibile con i sistemi che utilizzano i processori in banda base con interfaccia MDDI.

I bridge per display Toshiba TC358760XBG e TC358761XBG sono ottimizzati per i terminali mobili che usano l'interfaccia a pacchetti ad alta velocità MDDI e permettono di collegare display con interfaccia MIPI ai processori applicativi o in banda base dotati di interfaccia MDDI. Sono basati sulle interfacce MDDI 1.2 Type 1 e MIPI DSI 1.01, ma sono anche retrocompatibili con l'interfaccia MDDI 1.1. Supportano l'aggiornamento diretto tramite il collegamento MDDI. Inoltre, il circuito integrato TC358761XBG supporta anche le interfacce parallele tradizionali come MIPI DPI e MIPI DBI sul lato host o sul lato display, dando la possibilità di riutilizzare progetti o componenti esistenti. Questi dispositivi sono compatibili con i sistemi che utilizzano i processori in banda base con interfaccia MDDI.

Disponibilità

I prototipi del chip bridge per display TC358761XBG e del chip bridge per fotocamere TC358740XBG sono già disponibili. I prototipi del chip bridge per display TC358760XBG saranno disponibili da aprile 2010. L'avvio della produzione in grande serie del chip

TC358740XBG è prevista per il terzo trimestre 2010. L'avvio della produzione in grande serie dei chip TC358760XBG e TC358761XBG è previsto per il quarto trimestre 2010.

###

MIPI è un marchio usato su licenza di MIPI Alliance, Inc negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni. MDDI è un marchio registrato di Video Electronics Standards Association (VESA).

Informazioni su Toshiba

Toshiba Electronics Europe (TEE) è l'azienda che si occupa in Europa dei componenti elettronici del gruppo Toshiba, uno dei più grandi produttori di semiconduttori al mondo. Toshiba Electronics Europe offre una della gamme più complete di circuiti integrati e componenti discreti, tra cui memorie di fascia alta, microcontrollori, ASIC, ASSP e display per applicazioni nei settori automobilistico, multimedia, largo consumo, industriale, reti e telecomunicazioni. L'azienda offre anche una vasta gamma di soluzioni nel campo dell'elettronica di potenza.

TEE è stata fondata nel 1973 con sede a Ness (Germania) e si occupa di servizi di progettazione, marketing, vendite e produzione. La sede principale dell'azienda è oggi a Düsseldorf (Germania), mentre le sue filiali sono situate in Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. Il presidente dell'azienda è Hitoshi Otsuka e il numero totale di collaboratori in Europa è di circa 300.

Toshiba Corporation è un'azienda leader mondiale nell'innovazione e l'utilizzo di tecnologie avanzate, un produttore diversificato di prodotti elettrici ed elettronici avanzati utilizzati nei sistemi di comunicazione e informatica, prodotti digitali di largo consumo, componenti e dispositivi elettronici, sistemi di produzione dell'energia, incluse le centrali nucleari, sistemi industriali, infrastrutture sociali ed elettrodomestici. Fondata nel 1875, Toshiba attualmente coordina una rete globale di oltre 740 aziende, con circa 199.000 collaboratori nel mondo e un fatturato annuo complessivo superiore a 73 miliardi di dollari.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo www.toshiba-components.com

Indirizzo di riferimento da pubblicare:

Toshiba Electronics Europe, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79 197

Web: <http://www.toshiba-components.com/pressoffice/index.asp>

E-mail: ASIC/SOC: customsoc-internet@toshiba-components.com

Contatto per i giornalisti:

Henning Rausch, Toshiba Electronics Europe

Tel: +49 (211) 5296 117

E-mail: HRausch@tee.toshiba.de

Comunicato emesso da:

Simon Flatt/Andrew Town, Pinnacle Marketing Communications Ltd,

Prosperity House, Dawlish Drive, Pinner, Middlesex, HA5 5LN, UK

Tel: +44 (0) 20 8869 9229/+44 (0) 20 8429 6546 Fax: +44 (0) 20 8868 4373.

E-mail: simon@pinnaclemarcom.com or andrew@pinnaclemarcom.com

Web: www.pinnacle-marketing.com

Febbraio 2010 Rif.: 5997/A